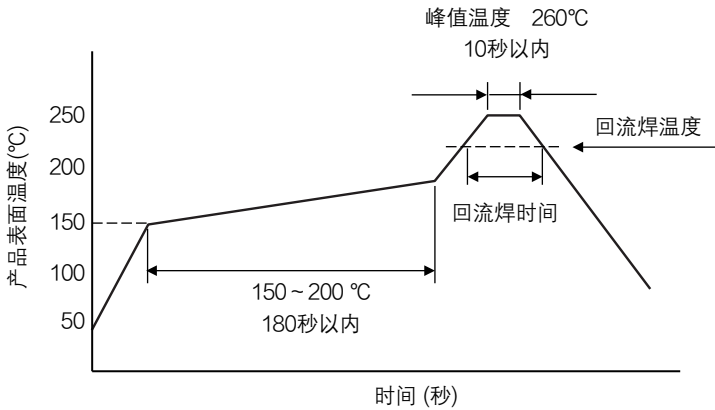


贴装规格

● 锡焊推荐条件



回流焊在下列回流焊条件下至多3次。

回流焊温度和时间

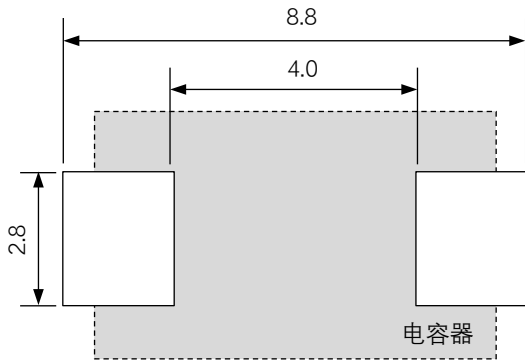
温度	时间
255°C以上	30秒以内
230°C以上	130秒以内
217°C以上	150秒以内

回流焊满足
IPC/J-STD-020D 符合

● 参考焊盘尺寸

□ 2端子产品

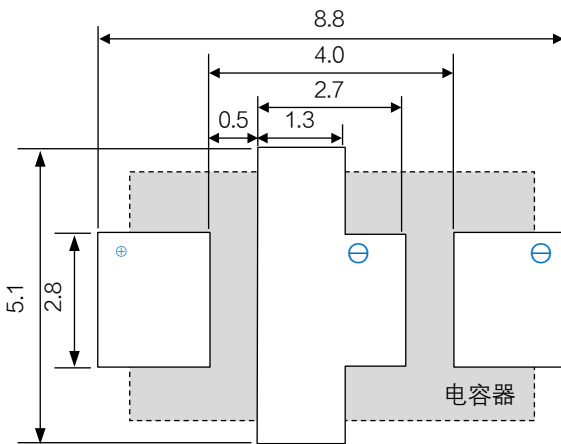
标准端子形状用 (C*, S*, G*, KX, JX, HX 系列)



单位:mm

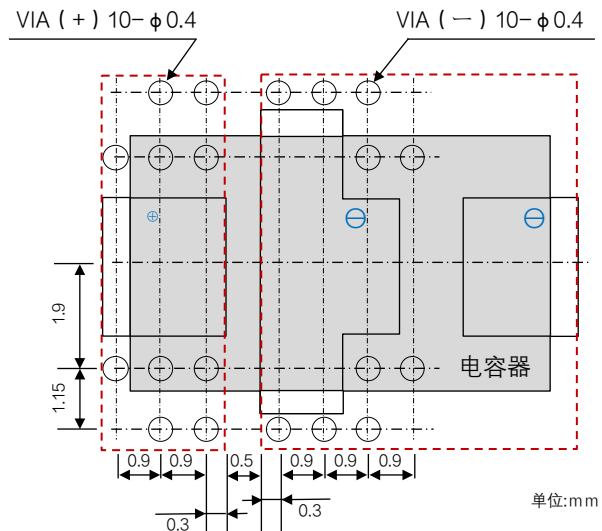
□ 3端子产品

用于低ESL端子形状 (L*, GX-L 系列)



〈VIA盘尺寸〉

用于低ESL端子形状 (L*, GX-L 系列)



单位:mm

